



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20050411001A

2010 年 4 月 19 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

営業・技術本部 カスタマドキュメント

マネージャ 牧 達郎 (牧)

TI-Taiwan サイト製造 QFP パッケージ 一部製品 グリーン化対応モールド樹脂変更のご案内

(認定済 57 製品への追加認定 3 製品の連絡)

(初版 PCN20050411001 2005 年 5 月 13 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site ☐ Process ☒ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	下記変更について認定済 57 製品への追加認定 3 製品の連絡になります。 TI-Taiwan サイト製造 QFP パッケージ 一部製品 グリーン化対応モールド樹脂変更 現行：モールド樹脂 グリーン化未対応 変更後：モールド樹脂 グリーン化対応	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	追加認定品は 7 月下旬の出荷より予定しています。 認定終了品は 2005 年 7 月下旬の出荷より実施しています。	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり
備考	—	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について認定済 57製品への追加認定 3製品の連絡になります。
 弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TI-Taiwan(台湾)サイト製造 QFPパッケージ 一部製品について、現行 グリーン化未対応モールド樹脂を使用して製造していますが、グリーン化対応部材使用による環境改善の為に、これに替わり、グリーン化対応モールド樹脂 (Hitachi 社 CEL9200HF13/CEL9200HF13-U (low alpha version))へ変更し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

モールド樹脂

現行

グリーン化未対応

変更後

グリーン化対応

理由：グリーン化対応部材使用による環境改善の為

対象製品リスト

対象製品名				
■: 追加認定品 □: 認定終了品				
SN32475PN	SN74ABT7820-20PN	SN74ACT7807-25PAG	SN74ACT7881-30PN	SN74V225-7PAG
SN74ABT7819-10PN	SN74ABT7820-25PN	SN74ACT7807-40PAG	SN74ACT7882-15PN	SN74V235-10PAG
SN74ABT7819-12PN	SN74ABT7820-30PN	SN74ACT7808-20PAG	SN74ACT7882-20PN	SN74V235-15PAG
SN74ABT7819-15PN	SN74ACT2235-20PAG	SN74ACT7808-25PAG	SN74ACT7882-30PN	SN74V235-20PAG
SN74ABT7819-20PN	SN74ACT2235-30PAG	SN74ACT7808-30PAG	SN74LVT8986PM	SN74V235-7PAG
SN74ABT7819-30PN	SN74ACT2235-40PAG	SN74ACT7808-40PAG	SN74V215-10PAG	SN74V245-10PAG
SN74ABT7819A-10PN	SN74ACT2235-60PAG	SN74ACT7811-15PN	SN74V215-15PAG	SN74V245-15PAG
SN74ABT7819A-12PN	SN74ACT7802-25PN	SN74ACT7811-18PN	SN74V215-20PAG	SN74V245-20PAG
SN74ABT7819A-15PN	SN74ACT7802-40PN	SN74ACT7811-20PN	SN74V215-7PAG	SN74V245-7PAG
SN74ABT7819A-20PN	SN74ACT7802-60PN	SN74ACT7811-25PN	SN74V225-10PAG	TLC320AC01CPM
SN74ABT7819A-30PN	SN74ACT7807-15PAG	SN74ACT7881-15PN	SN74V225-15PAG	TLC320AC01CPMR
SN74ABT7820-15PN	SN74ACT7807-20PAG	SN74ACT7881-20PN	SN74V225-20PAG	TLC320AC02CPM

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TVP5150PBS	Die Rev/Size (mils):	A/110 X 110	
Wafer Fab Site:	DM5	Fab Process:	1833C05.X4L	
Assembly Site:	TAIWAN	Package Code/Pins:	PBS/32	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL9200HF13	
Bond Wire:	TS-0.95 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-3/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
Temp Cycle	-65/150C, 2000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 hours	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	TLV320A10QPFB	Die Size (mils):	127 X 127	
Wafer Fab Site:	DFAB	Fab Process:	A21	
Assembly Site:	TAIWAN	Package Code/Pins:	PFB/48	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL9200HF13	
Bond Wire:	TS-0.95 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-2/260C	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 hours	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	SN105210PDT	Die Size (mils):	239 X 239	
Wafer Fab Site:	MIHO	Fab Process:	C12	
Assembly Site:	TAIWAN	Package Code/Pins:	PDT/128	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL9200HF13	
Bond Wire:	TS- 0.95 mils, Au	Leadframe(Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-3/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
Temp Cycle	-65/150C, 2000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 hours	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3 / 260C	12/0	12/0	12/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	TNETV901APAG	Die Rev/Size (mils):	B/206 X 192	
Wafer Fab Site:	KFAB	Fab Process:	EPIC.35 (C035)	
Assembly Site:	PHILIPPINES	Package Code/Pins:	PAG/64	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL-9200HF13	
Bond Wire:	TS-0.95 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-4/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	125C, 1000 Hours	40/0	40/0	40/0
**THB	85C/85%RH, 1000 Hours	26/0	26/0	26/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 hours	77/0	77/0	77/0
ESD- CDM	750V	5/0	5/0	5/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Notes:				
** Preconditioning sequence, JEDEC L-4/260C,C035 Devices shall be released at JEDEC L-4/260C at this time				

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	SN104950PAG	Die Rev/Size (mils):	D/191 X 158	
Wafer Fab Site:	MH6	Fab Process:	50A12.23LO	
Assembly Site:	TAIWAN	Package Code/Pins:	PAG/64	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL-9200HF13	
Bond Wire:	TS-0.95 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-2/260C	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	40/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	40/0
ESD-CDM	750V	5/0	5/0	5/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-2/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	DLF2401AVFA	Die Rev/Size (mils):	C/181 x 192	
Wafer Fab Site:	DM5	Fab Process:	EPIC.35 (F10)	
Assembly Site:	PHILIPPINES	Package Code/Pins:	VF/32	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL-9200HF13	
Bond Wire:	24.3UM, AU-TI	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-3/260C	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 hours	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
ESD-CDM	750V	5/0	5/0	5/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TLV320AIC22PT	Die Rev/Size (mils):	B/185 X 182	
Wafer Fab Site:	MH6	Fab Process:	33A12	
Assembly Site:	TAIWAN	Package Code/Pins:	PT/48	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL9200HF13	
Bond Wire:	TS-0.95 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-3/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 2000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 hours	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3 / 260C	12/0	12/0	12/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	TLS1056APZ	Die Size (mils):	232 X 242	
Wafer Fab Site:	HIJI	Fab Process:	Lin-ImpactC50	
Assembly Site:	TAIWAN	Package Code/Pins:	PZ/100	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL9200HF13	
Bond Wire:	TS-0.95 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-3/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 hours	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3 / 260C	12/0	12/0	12/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TMS320F206PZ	Die Rev/Size (mils):	2.2/384 X 326	
Wafer Fab Site:	HOU	Fab Process:	EPIC.70	
Assembly Site:	PHILIPPINES	Package Code/Pins:	PZ/100	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL9200HF13	
Bond Wire:	AU T1-24.3UM	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-1/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 hours	77/0	77/0	77/0
ESD-CDM	750V	5/0	5/0	5/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Note:				
** Preconditioning sequence, JEDEC L-1/260C. Devices with a die area to package area ratio greater than 0.17 will be de-rated to JEDEC L-2/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	F741719APDV-A	Die Rev/Size (mils):	D/142x142	
Wafer Fab Site:	DM5	Fab Process:	EPIC.15	
Assembly Site:	PHILIPPINES	Package Code/Pins:	PDV/128	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL9200HF13	
Bond Wire:	24.3 UM (0.95MILS)	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-3/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 hours	77/0	77/0	77/0
ESD-CDM	750V	5/0	5/0	5/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	F741598PEF	Die Size (mils):	461 x 458	
Wafer Fab Site:	DM4	Fab Process:	EPIC.15	
Assembly Site:	PHILIPPINES	Package Code/Pins:	PEF/256	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL9200HF13	
Bond Wire:	24.3 UM	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-1/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 hours	77/0	77/0	77/0
ESD-CDM	750V	5/0	5/0	5/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-1/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 7 月 28 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	S471AF138PZQR	Die Rev/Size (mils):	E/288x309	
Wafer Fab Site:	ANA	Fab Process:	EPIC.40	
Assembly Site:	PHILIPPINES	Package Code/Pins:	PZ/100	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	CEL 9200HF13	
Bond Wire:	TS-0.96 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L-3/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	125C, 1000 Hours	40/0	40/0	40/0
**THB	85C/85%RH, 1000 Hours	26/0	26/0	26/0
Bond Strength	-	22/0	22/0	22/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability (Assembly)	-	Approved		
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C				